

# 樹脂系材料の高温・超低荷重クリープ試験

超低荷重(0.49N/0.05kgf以上)で、クリープ特性を高精度に測定することが可能です。

## 特徴

- ① JIS Z 2271/K 7115準拠
- ② 種々の材料/試料形状に対応 : 樹脂、金属/薄板、フィルム、箔、紐状
- ③ 超低荷重から試験可能 : 0.49N(0.05kgf)程度以上
- ④ 非接触変位計の適用 : 超低荷重に影響を与えず、精度良くクリープ変位の計測が可能

## 測定可能範囲

- 供試材料
  - ・樹脂 : ゴム、プラスチックから複合樹脂材料まで
  - ・金属 : 鉄鋼、非鉄材料
- 試料形状
  - ・樹脂 : 薄板、フィルム/紐状 (厚さ:2~0.03mm, 直径:2~3mm)
  - ・金属 : 薄板、箔/ワイヤー (厚さ:0.5~0.05mm, 直径:1mm)
- 試験荷重
  - ・樹脂 : 0.49N(0.05kgf)以上
  - ・金属 : 1.96N(0.2kgf)以上
- 試験温度
  - ・室温
  - ・50℃以上
- クリープ変位
  - ・試験片に負荷のかからない非接触方式でクリープ変位を計測
  - ・測定精度 : 2μm
- 負荷方式
  - ・試験片に直接試験荷重を負荷します。(直荷重式)
  - ・試験荷重は速やかに、かつ衝撃を極力加えないように負荷することができます。

※試験前後の材質変化などの総合評価にも対応可能です。



試験機外観写真